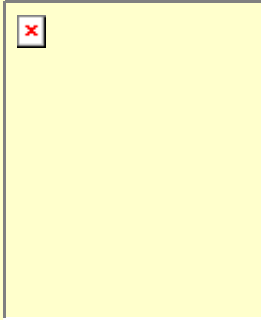


本期封面



2000年1期

栏目:

DOI:

论文题目: 复合SnPb焊点的形态与可靠性预测

作者姓名: 朱奇农 王国忠

工作单位: 中国科学院上海冶金研究所, 上海 200050

通信作者: 朱奇农

通信作者Email:

文章摘要: 建立了复合焊点形态的能量控制方程, 采用Surface Evolver软件模拟了复合SnPb焊点(高Pb焊料凸点, 共晶SnPb焊料圆角)的形态. 利用复合SnPb焊接点形态的计算结果.

关键词: 电子封装 焊点

分类号: TG40 0241.82

关闭